



Technical Data Sheet

FeedBond® BP-1200-SRG1

熱固型導熱矽膠

A. 產品說明

FeedBond® BP-1200-SRG1 單組份可熱固化的有機矽膠，是為 IC 封裝應用而開發，具有高導熱性、良好的熱穩定性和優異的電性能。

B. 產品特性

- 無添加溶劑
- 高導熱係數
- 適用於點膠作業

C. 產品規格

硬化前特性	值	測試條件	測試方法
外觀	灰色	目視	
黏度 @25°C	5000 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數	1.5	Brookfield DV-III/CP-51 @25°C	FT-P008
操作時間	10 小時	黏度增加 50% @ 5rpm	FT-P024

硬化條件	測試條件
標準硬化條件	烘箱烘烤 90 分鐘 @125°C 或 烘箱烘烤 60 分鐘 @150°C

硬化特性	值	測試條件	測試方法
外觀	灰色	目視	
比重	2.3	比重計	FT-P001
硬度	20	硬度計 Type 00	FT-P037
熱傳導係數	5 W/mK	Hot Disk(Sensor 5465、Slab model)	FT-P022

包裝和貯存條件	
包裝	50gm (針筒)
貯存條件	-40°C，可保存 3 個月

此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。



D. 使用指導方針

1. 表面必須清潔乾淨。
2. 白金觸媒會與某些化合物形成錯體，阻礙觸媒作用，導致硬化不良。
3. 如果基材抑制固化的能力未知，則應進行小規模測試以確定相容性。
4. 避免下列物質：
 - ① 有含N·P·S等有機化合物
 - ② Sn·Pb·Hg·Sb·Bi·As等重金屬的離子(ion)性化合物
 - ③ 含有乙炔基(acetylene)等不飽和基的有機化合物

E. 運輸

運送過程皆放入低溫冰袋等低溫保存以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無冰塊殘留，請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

F. 回溫解凍

解凍時將容器垂直放置，直到完全達室溫時才能使用，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

G. 貯存

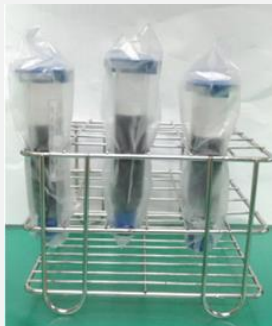
當您收到貨品時，請立即以低溫儲存@ -40°C，由於不同溫度下之保存將影響產品的保存期限。

H. 包裝

包裝為依照客戶需求選擇針筒或塑膠罐包裝，如需要詳細資料請聯絡 Feedpool 客戶服務及銷售部門。

I. 標準作業程序(SOP)

1. 將產品存放在未開封的容器中，放在乾燥的地方。最佳儲存條件：-40°C。
2. 使用前先將針筒放置在室溫環境下解凍(解凍過程約 60 分鐘之後才可使用)。
3. 從-40°C 冰箱中取出後，將針筒直立放置，向下傾斜同時解凍。
4. 在未達到解凍時間之前不要打開外包裝，如下圖所示。



5. 使用前應清除容器上積聚的水份，避免取出的產品可能受到污染，請勿將產品放回原始容器中。
6. 解凍後必須在 8 個小時之內使用完畢。